

## 關於公司開始在台灣提供之無電解 UBM 鍍膜代工服務

各位媒體先進：

本公司 J X 日鑛日石金屬株式會社 ( 總公司：日本國東京都千代田區大手町二丁目 社長：大井滋 ) 為了提升對台灣半導體產業客戶之服務，子公司台灣日鑛金屬股份有限公司 ( 總公司：台灣桃園市龍潭 總經理：諏訪邊武史 ) 的龍潭工場開始提供無電解 UBM \* 1 鍍膜代工服務。

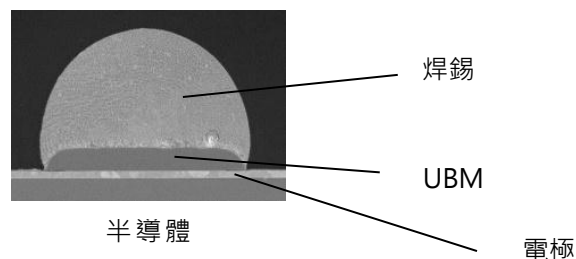
台灣擁有眾多具全球代表性的代工廠等半導體生產廠商，隨著半導體產業的成長與技術的進步，預估 UBM 鍍膜的需求也將隨之增加。本公司 2008 年起於磯原工場 ( 日本國茨城縣北茨城市 ) 提供此服務，但基於對台客戶的銷售情況穩定，並因應今後的需求成長，遂將相同製程引進台灣桃園龍潭工場，藉此可縮短交期，提升對客戶的服務品質。

本公司自行研發的鍍膜液及獨特製程之無電解鍍膜技術，是藉由選擇性鍍膜和批次處理，來達到低成本、短交期的目的。

從 BCP(事業永續計畫) 的觀點來看，此次龍潭工場引進與磯原工場相同之製程與設備，未來可由日本與台灣 2 個據點來提供代工服務，等於是強化了公司體制。本公司集團今後將更加努力，提升對客戶的服務品質，並確立穩定供貨體制。

\*1 UBM ( Under Bump Metallurgy 凸塊下冶金層 ):

半導體前製程中，在已形成電路的晶圓電極焊點上，會鍍上一層金屬膜以提升焊錫的密著度。隨著半導體封裝技術的小型化、高集積化，LSI 或 IC 等晶片的接合方法中，被擴大採用的「覆晶法」就必須使用 UBM 製程。



( 參考資料 )

## 台灣日鑛金屬股份有限公司龍潭工場概要

- ( 1 ) 地址： 台灣桃園市龍潭
- ( 2 ) 員工人數： 約 190 名 ( 2014 年底時 )
- ( 3 ) 工場面積： 佔地 約 30,000 m<sup>2</sup>
- ( 4 ) UBM 鍍膜代工服務開始時間： 2015 年 3 月

## 台灣日鑛金屬股份有限公司概要

### ( 1 ) 代表人

董事長： 堀 一浩

總經理： 諏訪邊武史

### ( 2 ) 資本額及股東

資本額： 新台幣 63.5 百萬元

股東： J X 日鑛日石金屬株式會社 83.7%

J X 金屬商事株式會社 15.0%

J X 日鑛日石分條中心 1.3%

### ( 3 ) 主要據點

總公司龍潭工廠： 桃園市龍潭區龍園一路 88 號

觀音工廠： 桃園市觀音區經建四路 45 號

彰濱回收中心： 彰化縣線西鄉安南三路 3 號

台中營業所： 台中市西區公益路 161 號 13 樓之 4

台南營業所： 台南市善化區光復路 496 號

### ( 4 ) 事業內容

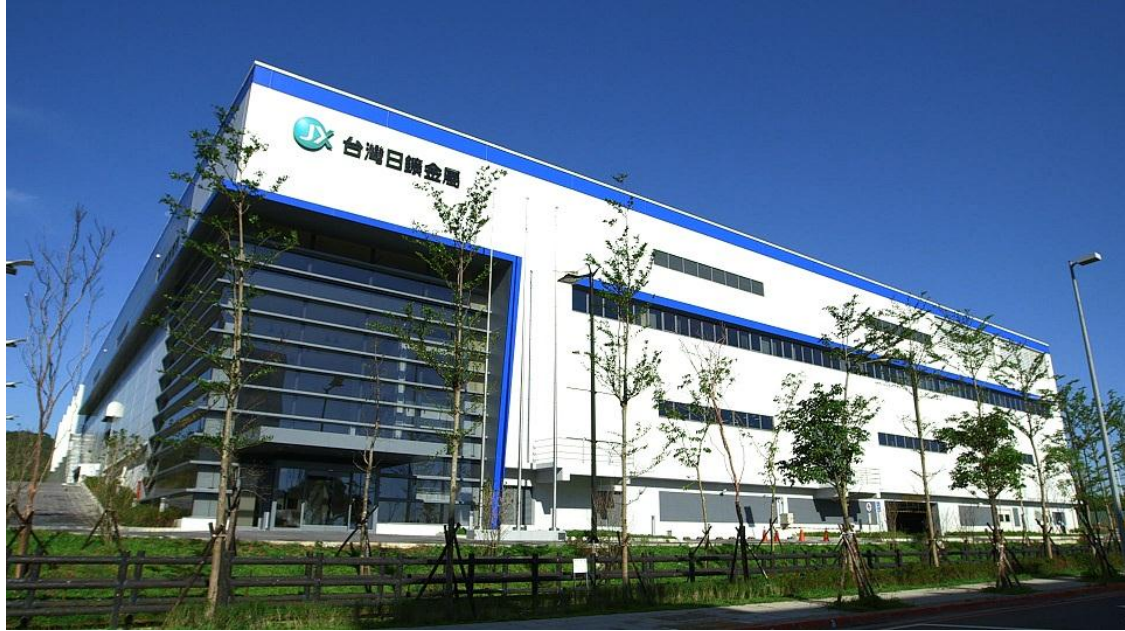
電子材料產品之產銷

金屬加工製品之裁切、銷售

各種工業品之銷售

金屬廢料及廢銅等之回收、銷售

電子零件、汙泥沈澱物等含金屬回收原料之回收、銷售



龍潭工場

此致

J X日鑛日石金屬株式會社

2015年3月25日